

令和1年11月5日

分任支出負担行為担当官

防衛装備庁電子装備研究所

総務課長 羽野 和志

入札結果等に係る情報

品 件 名 及 び 数 量	半導体HPAの高出力マイクロ波技術に関する動向調査
公 告 番 号 及 び 公 告 日	公告第62号 (1.9.5)
入 札 日	令和1年11月5日
契 約 日	令和1年11月5日
落 札 者 名	富士通株式会社
落 札 者 の 住 所	神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号
落 札 価 格 (税 込)	¥3,610,200.-
予 定 価 格 (税 込)	同種の他の契約の予定価格が推測されるおそれがあるため公表しない。
技 術 点 の 構 成	総合評価点 120点 (価格点 0点・技術点 120点)

入 札 者 名	入札価格 (税抜)	技術点の合計	総合評価点
富士通株式会社	¥3,518,000.-		
(2回目)			
富士通株式会社	¥3,422,000.-		
(商議1回目)			
富士通株式会社	¥3,387,000.-		
(商議2回目)			
富士通株式会社	¥3,317,000.-		
(商議3回目)			
富士通株式会社	¥3,282,000.-	120点	120点